

近期半導體板塊表現活躍，CPU 漲價為核心催化，在 AI 浪潮與供需優化下賽道成長邏輯清晰，帶動 CPU 等晶片概念股走強，科創晶片 ETF(588200.SH)月漲近 18%並連續 5 周收陽線。供應鏈顯示，英特爾、AMD 已售罄 2026 年大部分伺服器 CPU 產能，計畫當年 Q1 將產品價格上調 10%-15%；英特爾此前便因半導體基板短缺，自去年 Q4 起優先保障相關供應。成本端看，AI 伺服器需求推高存儲晶片價格並傳導至 CPU，疊加高端產能向 AI 晶片傾斜，消費級 CPU 供應趨緊；而 AI 向 agentic AI 演進帶來通用算力需求增長，英特爾傳統伺服器業務有望重回增長軌道。英特爾預計 2026 年伺服器晶片需求年增速 30%-40%，雖受記憶體供應限制或腰斬，但仍遠超華爾街 4%-6%的預測。當前 AI 算力重構半導體產能疊加數據中心升級，2026 年 CPU 價格有望持續上升，其角色從“系統調度”轉向 AI 全流程核心算力，成為市場關注的焦點。

兩巨頭產能售罄，行業供需趨緊致價格上漲，CPU 板塊行情來了？

上周半導體板塊表現活躍，CPU 漲價成為核心催化因素，疊加 AI 產業浪潮推進與供需格局優化，CPU 賽道成長邏輯愈發清晰。市場表現方面，國內包括 CPU、GPU 在內的晶片板塊上周表現較為強勁，多股股價創區間新高，算力晶片尤其 CPU 概念股漲幅居前。據供應鏈消息，英特爾和 AMD 已售罄 2026 年大部分伺服器 CPU 產能，並計畫在當年第一季度上調伺服器處理器價格 10%-15%，而英特爾此前因伺服器和 PC 產品的半導體基板供應短缺，已從去年 Q4 起優先保障相關供應，其產能向伺服器端傾斜還導致消費端 CPU 交付率下滑。認為目前 CPU 正如同去年的存儲晶片，從算力配角轉變為決定 AI 系統整體性能的關鍵約束因素，尤其是在複雜的 Agent 廣景下，傳統以 GPU 為中心的算力架構正面臨前所未有的壓力。

從成本傳導端來看，AI 伺服器的強勁需求推高存儲晶片價格，成本傳導效應進一步帶動 CPU 價格上漲，同時高端產能向 AI 晶片傾斜，也使得消費級 CPU 供應趨緊。隨著 AI 從簡單助手演進為可規劃執行任務的 AI 代理（agentic AI），市場對通用計算能力的需求加速增長，CPU 需求水漲船高，英特爾的傳統伺服器業務也有望借此“重新回到增長軌道”。英特爾預計，2026 年伺服器晶片市場需求年增長率將達 30%-40%，儘管記憶體晶片供應受限可能導致實際增速腰斬，但這一水準仍顯著高於華爾街預測的 4%-6%的年增長率。市場也因此將 CPU 視為“下一個存儲的機會”，並認為在 AI 時代，計算產業發展的重點在於計算架構創新，CPU 等通用計算的重要性有望進一步提升，疊加新型



計算場景對運算速度、精度的要求不斷提高，作為計算領域基礎設施的 CPU，其價值將進一步凸顯。

圖一：國內晶片指數近半年走勢情況



資料來源：Wind

➤伺服器 CPU 供需緊張格局的背後邏輯何在？

*供應鏈情況：缺貨與漲價較為確定

英特爾 (Intel) 與超微半導體 (AMD) 兩大行業巨頭的動向，直觀印證了當前伺服器 CPU 市場供需緊張的格局。KeyBanc 數據顯示，為緩解供需失衡壓力、保障後續供應鏈穩定，兩家企業計畫將伺服器 CPU 產品價格上調 10%-15%。尤為值得關注的是，上述兩家廠商 2026 年的伺服器 CPU 產能已基本完成預售，這一現象充分凸顯出市場端的旺盛需求，以及當前產業鏈供應端的緊張態勢。

從供給端來看，當前伺服器 CPU 市場正陷入典型的產能零和博弈困境，核心瓶頸集中在先進制程與封裝產能的分配失衡。高性能 AI GPU 與高端伺服器 CPU 均高度依賴臺積電等頭部代工廠產能，而 KeyBanc 調研數據顯示，臺積電 2026 年僅能滿足約 80% 的 CPU 晶圓需求，根本原因在於先進制程產能持續向高利潤的 AI GPU、AI ASIC 傾斜，其 7 納米以下先進制程營收占比已達 74%，其中 5 紳米、3 紳米分別占 37%、23%，直接擠壓了伺服器 CPU 所需制程的產能空間。疊加超大規模雲廠商大幅上修 2026 年伺服器採購計畫，以及 2025 年下半年起 DRAM 價格飆升帶來的整機成本上升，部分 OEM 廠商選擇推遲消費級 PC 出貨、優先保障高毛利伺服器業務，這種需求結構性轉移進一步加劇了伺服器 CPU 紧缺，而代工廠將先進封裝產能優先供給英偉達 AI GPU 的策略，更從物理層面壓縮了伺服器 CPU 的供給，推動 CPU 市場從“買方市場”快速轉向“賣方市場”，為銷量及 ASP 提升奠定基礎。



從需求端來看，AI 需求端的結構性轉變，成為伺服器 CPU 需求激增的核心驅動力，伴隨 AI 從“訓練為主”向“推論主導”的轉型，CPU 的戰略價值持續凸顯。訓練階段依賴 GPU 集群處理海量數據與複雜運算，而推論階段作為模型應用環節，雖計算量較小但強調低延遲、廣部署與能效性，更適配 CPU 通用、節能、支持多任務處理及集成 AI 加速器的特性。近年來 AI 應用爆發式增長推動推論需求指數級上升，2026 年全球 AI 服務每天將處理數十億次查詢，推論占 AI 計算比重超 70%，市場預測當年推理晶片需求將超越訓練。同時，通用伺服器進入更新週期、雲廠商數據中心架構升級帶來的補償性投資，與 AI 推理伺服器出貨量的快速增長形成共振，據 TrendForce 數據，2026 年全球 AI 伺服器出貨量同比增幅將超 20%，占整體伺服器出貨量比重有望升至 17%，多因素疊加推動伺服器 CPU 需求及價格同步上漲。

另外，代理式 AI (Agentic AI) 的興起，進一步重塑了 CPU 與 GPU 的協同關係，強化了 CPU 在算力體系中的核心地位。當 AI 從聊天機器人進化為可自主行動的“智能體”，計算負載發生質的變化，智能體需圍繞 GPU 集群開展大量編排、調度、預處理及沙盒式操作，形成“GPU 負責核心計算、CPU 負責管理組織”的協同算力體系。智能體複雜度越高，對 CPU 的依賴度越強，CPU 成為銜接 GPU 集群與各類終端應用的關鍵樞紐。這一趨勢也為 CPU 短缺敘事提供了更強支撐，英特爾此前提及的產品線供應偏緊狀況，與 Agentic AI 帶來的新需求形成呼應，使 CPU 不僅在推論場景中與 GPU 同等重要，更在智能體驅動的新型算力架構中，成為不可或缺的核心組件，推動市場對 CPU 的重視度與需求度持續攀升。

圖二：Agentic AI 工作流



資料來源：慧博投研，IDC



*國產化發展機遇：技術迭代追趕與市場份額拓展

在進口伺服器 CPU 供應持續緊張、價格迎來 10%-15% 上調的行業背景下，國產 CPU 廠商正迎來前所未有的發展窗口期與市場機遇。一方面，以 Intel、AMD 為代表的國際巨頭不僅上調產品售價，其 2026 年伺服器 CPU 產能更已基本預售完畢，供需失衡的格局直接倒逼下游雲計算廠商、政企數據中心等核心客戶加速供應鏈多元化佈局；另一方面，國內 “自主可控” 的產業政策導向持續加碼，為國產 CPU 的技術迭代與市場滲透提供了強勁的政策支撐，雙重利好因素疊加之下，國產 CPU 賽道的成長確定性顯著提升。

近年來，國產新一代伺服器 CPU 的技術成熟度與商業化進程均實現跨越式突破，已在通用伺服器、存儲伺服器等核心場景加速落地應用。在通用伺服器領域，國產 CPU 憑藉與國產操作系統、資料庫的良好適配性，成功切入政務雲、金融信創等關鍵領域，滿足高併發、高穩定性的業務需求；在存儲伺服器場景，其在數據讀寫效率、能耗控制等指標上的表現已逐步接近國際同類產品水準，成為部分中小企業替換進口產品的優選方案。與此同時，頭部國產 CPU 廠商還在持續加大研發投入，推動制程工藝與指令集架構的優化升級，進一步縮小與國際巨頭的技術代差，為後續拓展更廣闊的市場空間築牢根基。

*國內有哪些公司有望受益？

CPU 賽道作為半導體產業的核心算力賽道，2026 年迎來 AI 算力爆發、全球供需失衡、國產替代加速與政策紅利的多重共振，成長確定性凸顯。AI 大模型迭代、AI PC 規模化落地及智能體應用普及推動雲端與端側算力需求指數級增長，高端 AI 伺服器對 CPU 的性能、核心數要求大幅提升，而英特爾、AMD 等國際巨頭伺服器 CPU 全年產能售罄並啟動 10%-15% 提價，全球供需缺口持續擴大，為國產 CPU 打開關鍵市場窗口。在國內信創政策持續加碼、大基金三期重點扶持的背景下，海光、龍芯、飛騰等國產 CPU 企業實現技術突破，產品在政務、金融、運營商等領域批量出貨，自主架構研發與生態建設持續完善，市場份額快速提升，同時伺服器 CPU 架構向 x86、ARM、RISC-V 多元格局演進，疊加封測、記憶體介面晶片等產業鏈配套環節同步放量，CPU 賽道不僅成為 AI 算力基建的核心抓手，更憑藉國產替代的不可逆趨勢，成為貫穿 2026 年的核心科技投資主線，長期成長空間廣闊。

中國長城 (000066.SZ)

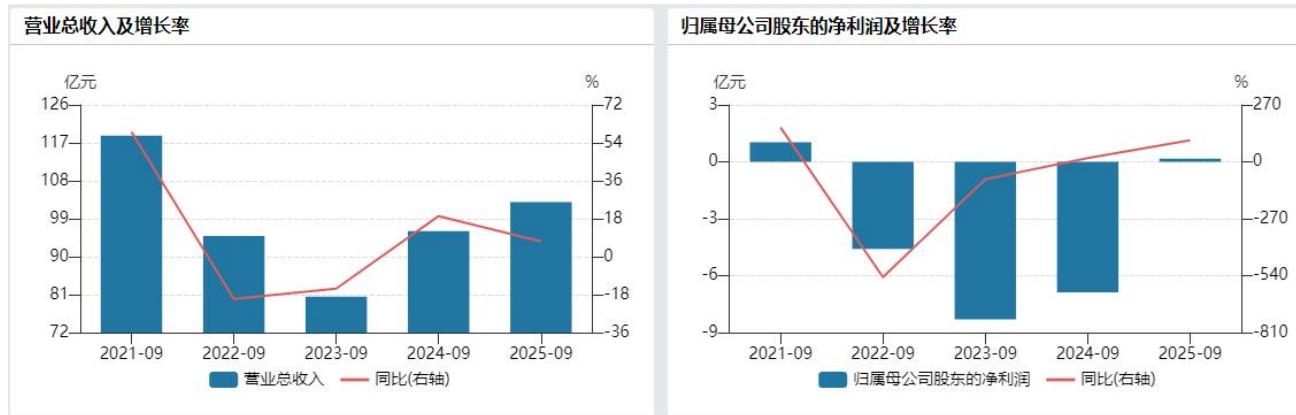
中國長城 (000066.SZ) 作為 CEC 旗下國產算力國家隊，核心價值在於深度綁定飛騰 CPU 構建的 “PKS 體系”（飛騰 CPU + 麒麟 OS + 安全）全棧自主可控生態，是國產 ARM 架構伺服器領域的絕對龍頭。公司依託 “晶片+系統+整機” 高度協同優勢，在黨政信創、金融、電信等關鍵行業滲透率持續提升，金融信創份額穩居第一梯隊，軍工市場需求穩定且具備高壁壘。飛騰最新 S5000C 算力較前代提升顯著，與華為鯤鵬共用軟體棧，整機互認證超 2000 款，天津基地年產晶片 60 萬顆，產能國內居首，為業績釋放提供堅實支撐。



公司正處於困境反轉關鍵拐點，2025 年度業績預告顯示歸母淨利潤虧損 3500 萬元至 7000 萬元，同比減虧 95.27% 至 97.63%，扣非後淨利潤減虧 50.01% 至 57.44%，主要得益於業務聚焦、毛利提升及非核心資產剝離帶來的投資收益。AI 算力建設與信創政策持續加碼背景下，公司伺服器訂單環比翻倍，飛騰 CPU 在 AI-Agent 訓練集群多核併發場景優勢凸顯，成為 CPU 出貨彈性最大的標的之一。此外，公司伺服器電源國內市占率第一，PC 電源 DIY 市場份額領先，有望充分受益於 AI 算力中心建設需求爆發，形成“算力底座+電源配套”雙輪驅動格局。

中長期來看，中國長城（000066.SZ）憑藉自主可控壁壘+生態協同優勢+業績改善動能，具備顯著的估值修復空間。其在能源、醫療等新行業的國產化替代持續推進，煤炭洗選工程 CPIM 平臺、全國產化運動控制器等產品已在千萬噸級煤礦落地，打破國外技術壟斷。隨著飛騰 CPU 性能持續逼近國際主流、生態適配不斷完善，以及公司盈利水準逐步改善，中國長城（000066.SZ）有望從“困境反轉”走向“算力重塑”，成為國產替代與 AI 算力浪潮中的核心受益者，建議逢調整佈局，重點關注 2026 年信創訂單落地與 AI 伺服器盈利轉化情況。

圖三：中國長城（000066.SZ）營收及淨利潤增長情況



資料來源：Wind

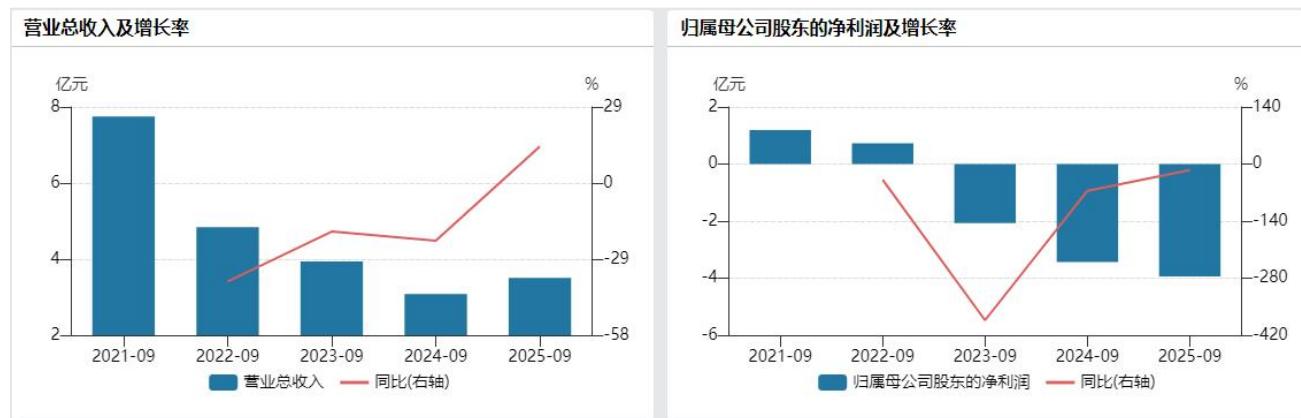
龍芯中科（688047.SH）

龍芯中科（688047.SH）作為國內唯一掌握完全自主指令集 LoongArch 的 CPU 龍頭，核心價值在於從底層架構到全棧生態的 100% 自主可控，徹底擺脫 x86 與 ARM 的授權依賴，為國產資訊技術體系築牢根基。公司 CPU 產品線全面覆蓋桌面（3A6000）、伺服器（3C6000）、嵌入式（2K3000）全場景，其中 3A6000 性能對標 Intel i5，是業內首個純裸機無加速卡通過 DeepSeek 適配認證的國產 CPU，3C6000 伺服器晶片通過自研龍鏈介面可擴展至 64 核 128 線程，性能對標至強 Gold 6338，已在政務雲、能源、金融等關鍵行業規模化部署。生態層面，龍芯適配軟體超 10 萬款，與漢騰科技、太初元碁合作的“五大萬卡集群專案”簽約，將打造年產十萬臺國產算力伺服器產線，標誌著龍芯 CPU 進入規模化商用新階段。



公司 CPU 業務正加速向 AI 算力與開放市場雙輪驅動轉型，2025 年發佈的 3B6000M 終端晶片集成自研 GPGPU，9A1000 AI 推理晶片研發進展順利，可滿足 AI-Agent 推理下沉場景需求。業績方面，隨著 3C6000 放量與行業信創集采推進，2025 年伺服器 CPU 出貨量同比增長超 80%，桌面 CPU 市占率穩居國產前三今日頭條。公司戰略清晰：以“自主安全+高性價比”雙優勢鞏固黨政軍市場，同時通過“CPU+GPU 深度協同”佈局異構計算，卡位 AI 推理與邊緣計算新賽道。隨著生態成熟度提升與先進制程晶片量產，龍芯有望從“政策驅動”轉向“市場驅動”，長期成為國產算力基礎設施的核心供應商，建議重點關注其 3C6000 規模化出貨與 AI 晶片落地節奏。

圖四：龍芯中科 (688047.SH) 營收及淨利潤增長情況



資料來源：Wind

長電科技 (600584.SH)

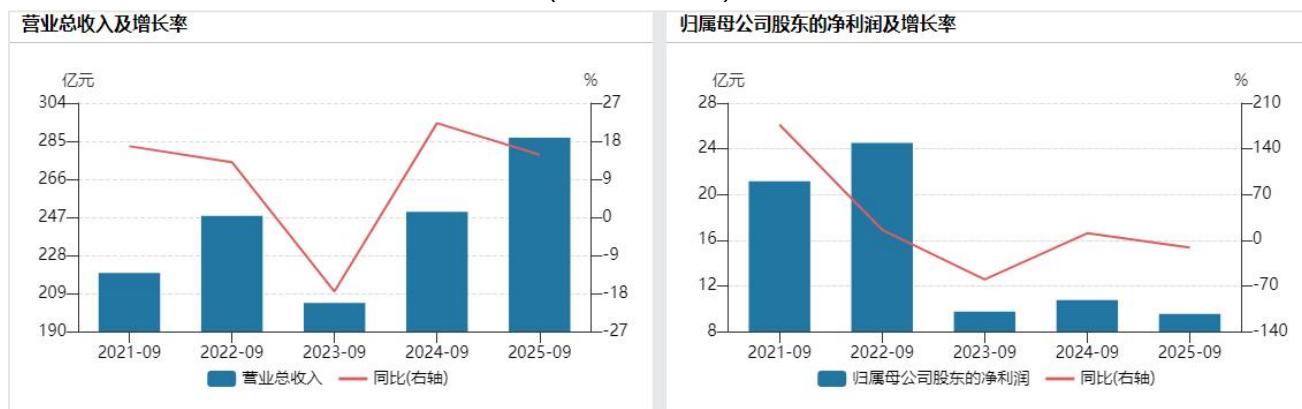
長電科技 (600584.SH) 作為全球第三大、中國大陸第一大半導體封測龍頭，正站在 AI 算力爆發與技術範式轉移的雙重風口，核心價值源於先進封裝技術領先與 CPU 等高端晶片封測的深度佈局 JCET Group。公司自主研發的 XDFOI® Chiplet 高密度多維異構集成平臺已穩定量產，涵蓋 2D/2.5D/3D 全系列集成方案，是國內唯一具備 2.5D/3D 全棧先進封裝能力的封測廠商，可高效集成不同制程的 CPU 與 GPU 晶片，成本較傳統 COC 降低 30%。在 CPU 封測領域，公司與英特爾建立深度“合夥人”關係，為 Xeon 系列伺服器 CPU 提供 Fan-Out、SiP 封裝服務，適配 EMIB 及 Foveros 技術，解決高性能計算晶片的互連與散熱難題；同時承接 AMD MI300 系列 APU 的 Chiplet 封裝，與 AMD 聯合開發 3D 堆疊技術獲 5 年框架協議。此外，公司為華為鯤鵬 920C 伺服器晶片提供定制化封裝方案，深度參與國產 CPU 生態建設，矽光引擎產品客戶樣品交付標誌著國產 CPO 技術從概念走向現實。

華潤集團 2024 年 3 月以 117 億元入主成為第一大股東，為公司帶來央企資源背書與資金支持，推動 CPU 等先進封裝產能擴張與技術研發提速。業績層面，2024 年營收 359.62 億元同比增長 21.24%，顯著領先國內同行；2025 年前三季度歸母淨利潤 9.54 億元，隨著行業週期復蘇與先進封裝占比提升（目標 2026 年達 30%），毛利率有望持續改善。CPU 封測業務是公司高端化轉型的核



心引擎之一，上海車規基地已投產，汽車電子 CPU/MCU 封測業務增長迅猛，目標 2026 年收入突破 100 億元。同時，公司積極拓展龍芯、海光等國產 CPU 廠商合作，受益於信創與國產替代浪潮，形成 AI 先進封裝 + CPU/GPU 高端封測 + 汽車電子 + 存儲封測四駕馬車驅動格局，長期有望從 "週期股" 蛻變為 "成長股"，建議重點關注其先進封裝產能釋放與國產 CPU 訂單落地節奏。

圖五：長電科技 (600584.SH) 營收及淨利潤增長情況



資料來源：Wind

免責聲明：本報內容所提供之資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本報內容僅供參考，不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券與虛擬資產價格可升可跌，尤其虛擬資產的風險極高，投資者應對有關產品保持審慎及自行承擔投資風險。

